股票简称:有方科技　　股票代码:688159

深圳市有方科技股份有限公司

SHENZHEN NEOWAY TECHNOLOGY CO. ,LTD.

(深圳市龙华区大浪街道同胜社区华荣路联建工业园厂房 2 号 4 层)

首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构(主承销商)

华创证券有限责任公司
HUA CHUANG SECURITIES CO., LTD.
(贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号)

二〇二〇年一月

特别提示

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“有方科技”、“公司”或“发行人”)股票将于 2020 年 1 月 23 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。

本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板,在企业上市首日涨幅限制比例为 44%,首日跌幅限制比例为 36%,之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板企业上市后的前 5 个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市 5 个交易日后,涨跌幅限制比例为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量

上市初期,原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月,保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月,高管及核心员工专项资管计划战略配售股份锁定期为 12 个月,网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后本公司的无限售流通股为 1,866.0655 万股,占发行后总股本的 20.35%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率处于较高水平

本次发行价格为 20.35 元/股,此价格对应的市盈率为:

1、36.99 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、32.17 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3、49.31 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、42.90 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,截至 2020 年 1 月 9 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 42.82 倍。本次发行价格对应的公司 2018 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 49.31 倍,高于行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)融资融券风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,特别关注以下重大风险提示,并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。

(一)上游芯片技术发展带来的发行人产品技术迭代的风险

在物联网领域,大部分带无线通信功能的终端设备均主要采用应用处理器与 Modem 模块(基带处理器及相关硬件和软件包,负责设备的无线通信功能)相结合的“Modem 模式”,公司的无线通信模块产品也主要通过该种模式应用于下游终端设备。随着半导体芯片的研发和制造工艺水平飞速的发展,集成电路性能得以大幅提升,单个微处理器芯片能够实现的功能越来越多。目前半导体芯片厂商在通用的基带芯片之外已推出包含无线通信功能及外带智能处理器的集成芯片(简称 SOC 芯片),采用“SOC 模式”的智能终端设备将不需要另行搭载 Modem 模块。SOC 芯片目前主要应用于智能手机和部分平板电脑等消费电子领域,未来若大量应用于物联网终端设备,将对公司和物联网无线通信行业现有主流技术模式有所影响。

上述“Modem 模式”和“SOC 模式”的主要特点对比如下表:

类别	Modem模式	SOC模式
性能优缺点	优点:不受集成限制,应用处理器功能性可根据产品的需要进行有效配置; 缺点:功耗较高。	优点:在特定的应用情况下可以完全发挥其各方面的性能组合优势; 缺点:高度集成导致产品缺乏灵活性。
成本	需配置多种芯片,原材料成本较高。	减少了芯片配置数量,降低原材料成本。
研发投入和周期	研发投入和周期较 SOC 方案较大程度减少和缩短。	设计难度与研发投入大,开发周期长,主要是因为:1、硬件配置规模庞大,通常基于 IP 设计模式;2、软件比重大,需要进行软硬件协同设计;3、仿真与验证过程复杂且耗时。
产品认证	Modem模块作为单独的部件会通过全球包括国内的各类级别的认证测试。因此采用应用处理器 +Modem 模块方式的移动终端设备,可以通过多种方式简便快速的获取同等级别的产品认证,从而降低门槛,并缩短产品进入市场的时间。	采用 SOC 方式做成的移动终端设备,由于产品的多样性和平台的复杂度,每款产品必须独立通过各类认证测试,大大增加产品入市的难度和时间。
市场应用和占有率	在物联网领域,绝大部分带无线通信功能的终端设备均主要采用该方案。	主要应用在智能手机和平板电脑等消费电子领域,其他应用领域尚未使用或普及。

终端设备选择哪一种无线通信方案主要取决于以下几个方面:

1、终端设备的功能定位和应用场景需求:对于应用处理多样性要求较高,倾向使用“Modem 模式”,以便于方案的灵活设计和配置,这种方案在物联网终端占比较大;而对于应用处理要求相对统一、与 SOC 平台本身的特性高度符合、无线通信功能作为标准功能配置的终端设备,则倾向于使用“SOC 模式”。

2、规模效应:对于物联网中各类智能终端设备,需求较为分散,市场呈现碎片化,“Modem 模式”仍是主流方案;而对于智能手机等消费电子设备,需求较为统一,市场规模大,拥有更低成本的“SOC 模式”更受青睐。

3、芯片供应商在不同领域的地位:在智能手机等无线通信产品领域,基带芯片供应商地位优势明显,因此“SOC 模式”得以大力推广;而在其他应用领域未出现该情形。

综上,公司所选取的“Modem 模式”是目前大部分物联网终端设备采用的主流方案,而集成应用处理功能的 SOC 芯片目前主要应用于智能手机和部分平板电脑等消费电子领域,前者的硬件方案具有应用处理多样化功能较强、灵活度较高、市场响应速度较快等特点,后者的硬件方案具有功耗较低、研发投入成本高、规模化后生产成本较低等特点。两者因各自特点差异适用于不同的应用领域和终端设备,未来“SOC 模式”的硬件方案不会必然对公司产品形成大规模替代。此外,公司已在 2017 年实现无线通信终端产品的销售,并在最近一年及一期保持了终端产品销售收入的快速增长,亦有效降低了上述潜在风险。

基带芯片等主要芯片的技术门槛高、研发周期长、资金投入大,相关厂商的盈利模式基本为:通过进行研发高投入,保持芯片的技术壁垒和迭代领先优势,向下游客户销售芯片的同时收取平台专利费等实现盈利。公司等无线通信模块研发企业是芯片厂商的下游企业,公司需结合行业客户具体需求,并根据上游芯片厂商的技术发展判断行业发展趋势和技术演变路径。公司是以研发和技术为核心驱动的企业,虽然公司高度重视芯片厂商的技术发展方向和路线,但如果公司不能正确判断行业发展趋势或对芯片技术演进路径不能正确做出判断和选择,可能导致公司产品布局出现偏差,从而对公司经营产生不利影响。

(二)5G 技术运用带来的发行人产品技术迭代的风险

1、5G 技术对公司中长期业务持续增长产生的风险

物联网产业发展迅速,蜂窝通信技术(2G/3G/4G/5G)的快速迭代为物联网行业不断带来新的应用场景和业务机会。5G 是目前蜂窝通信最前沿的演进技术,未来 5G 的大规模应用将会产生大量的物联网应用新需求。国际标准化组织 3GPP 定义了 5G 三大应用场景,包括:eMBB,适用于 3D/ 超高清视频等大流量移动宽带业务;mMTC,适用于大规模物联网业务;uRLLC,适用于无人驾驶、工业自动化等需要低时延、高可靠连接的业务。

不同通讯制式的产品有其各自适用的场景需求,且 5G 自推出到大规模应用需要长期庞大的基础通讯设施建设以及各类应用场景的需求逐步实现作为基础,因此短期内 5G 技术对公司产品现有主要应用行业及客户需求的影响有限。但如果公司在未来 5G 技术大规模运用中未能针对新的应用场景持续成功地进行技术及产品研发并及时满足市场和客户需求,将对公司业务的长期持续增长造成不利影响。

2、公司募集资金关于“5G 模块和解决方案研发及产业化项目”的规划和实施风险

公司在 5G 技术运用推广中需要选择恰当的时间以及合适的芯片平台进行产品的开发和市场布局,如果未选择稳定、可靠且具备性价比的芯片平台,可能导致公司的产品缺乏强有力的市场竞争力。目前中美贸易纠纷尚未明朗,正式推出了 5G 芯片平台的有美国高通、韩国三星、联发科和华为海思等,公司目前与主要芯片公司均保持紧密沟通交流,并将结合贸易环境和 5G 商用进度审慎选择。

基于以上因素综合考量,公司进行了较多 5G 相关关键技术和芯片平台的前期预研论证,并计划根据公司业务发展和融资进度,在未来 3 个月内审慎选定 5G 芯片平台,并在 2020 年尽早推出首款 5G 无线通信标准模块产品,且在当年完成测试验收及实现商业应用。

截至 2019 年 9 月 30 日具体相关预研情况及计划如下表:

研究事项	拟实现目标	进展情况
5G芯片平台预研	未来 3 个月内完成对比分析,确定 5G 产品选择的芯片平台。	处于针对 5G 芯片平台功能、性能、商务等方面的对比分析中。
5G关键技术预研	2020年一季度完成 5G 关键技术预研,为正式产品推出做准备: 1、完成 5G 天线与射频关键技术研究,包括 Sub-6GHz 和毫米波; 2、5G-NR 空口协议研究; 3、5G 重点业务标准通信模块应用研究。	1、已确定 5G 天线选型标准和关键指标;基于 5G 仪表确定测试方案和生产方案; 2、完成 3GPP 5G-NR 空口协议分析。

虽然公司已进行了较多 5G 相关关键技术和芯片平台的前期预研论证并将“5G 模块和解决方案研发及产业化项目”作为本次主要募投项目实施,但如果公司在 5G 技术运用中未能成功地进行技术及产品研发并及时满足市场和客户需求,将对公司的募集资金投资效益和生产经营造成不利影响。

(三)委外加工的风险

公司的产品采用委外加工方式生产。委外加工生产模式有利于公司将有限的资源集中于研发、销售等核心价值链,以能够适应行业技术和产品更新迭代快的特点,快速地推出适应市场需求的产品。公司在选择外协工厂时十分重视对方的资质信誉和生产能力,并且建立了一整套完善的生产运营、质量管控体系以保证外协加工产品质量。但由于公司销售的产品均通过委外加工生产,可能存在因外协加工产品质量、交货期等问题,导致公司产品品质降低、交货延误的风险,从而对公司的经营带来不利影响。

(四)主要原材料芯片依赖进口的风险

芯片是公司产品的重要原材料,报告期内,公司芯片采购支出占采购总额的比例分别为 74.61%、77.68%、69.48%和 64.13%。报告期内,公司芯片类原材料最终来源主要为境外厂商,比如高通、联发科、三星等,公司主要原材料芯片存在依赖进口的风险,具体来源国家(地区)及金额占比如下表:

国家(地区)	2019年1-6 月	2018年	2017年	2016年
美国	55.82%	64.75%	72.91%	56.07%
韩国	24.73%	16.61%	6.69%	17.71%
中国台湾	5.89%	10.03%	10.81%	11.05%
中国大陆	10.55%	4.08%	4.71%	8.67%
日本	2.66%	4.42%	4.73%	6.40%
其他	0.36%	0.11%	0.14%	0.11%

公司芯片类原材料来源中,美国占比最高,但自 2018 年有所下降。目前公司的基带芯片采购主要集中于高通与联发科,在物联网行业中,上述芯片生产厂商掌握核心生产技术,而国内芯片供应商的大规模进口替代需要规模化量产和应用进行验证;且在短时间内市场中可替代的芯片供应商较少;加之近年来部分发达国家经济增速放缓,国际贸易保护主义略有抬头之势,若未来因国际贸易摩擦导致芯片供应不足,或海外原材料供应商销售策略和销售价格发生较大幅度的波动,将对公司的原材料供应及产品成本产生不利影响,公司将会面临盈利水平下滑的风险。

公司根据客户的需求确定基带芯片及其他芯片、电子元器件的选型,目前,随着国内大力发展集成电路产业进程的深入,翱捷、展锐等公司研发实力的提升,报告期内公司采购的芯片从性能上不存在绝对不可替代的情况,并且在具体的工业应用上已经出现了成熟设计、小批量应用的产品。

1、智能电网领域芯片替代的影响分析

目前,智能电网和 4G 智能 OBD 车载为公司核心产品领域,公司已有采用翱捷 ASR1802 基带芯片的应用于智能电网领域的 N720 系列产品(以下简称“翱捷系列”),该芯片可以广泛替代公司目前采用高通基带芯片的应用于智能电网领域的 N720 系列产品(以下简称“高通系列”)。由于翱捷系列产品目前仅为小批量应用,产品成本相对较高,如果中美贸易摩擦进一步加剧,导致高通停止对华出售芯片,短时间内翱捷系列全部替代高通系列将会由于单位产品成本较高等原因造成公司翱捷系列单个产品毛利额及毛利率较低,将对公司短期利润造成一定影响。该种情况的短期模拟测算结果为以 2018 年为基准,将减少公司 2018 年度利润总额约 933 万元,占比为 20.08%,将造成一定影响。

在翱捷系列大规模应用且生产磨合良好、生产效率达标的情形下,根据公司翱捷系列产品的 BOM 物料成本和加工单价,将会明显降低单位产品成本,翱捷系列单个产品毛利额将与高通系列基本持平、差异极小,对利润的影响可以忽略不计。此外,基于翱捷的研发实力、业务布局以及与公司自 2017 年起开始建立的合作开发关系,未来随着国产化进程深入,成本下降带动销量的提升,最终芯片国产化亦有可能对公司的业绩产生积极影响。

2、以 4G 智能 OBD 为代表的其他产品领域

4G 智能 OBD 车载产品为公司核心产品之一,主要面向欧美高端市场客户,目前按照北美市场客户需求采用高通芯片。虽然公司具备根据客户的需求开发基于不同基带芯片的 4G 智能 OBD 等产品的能力,但重新开发及认证的周期较长。

基于中国是美国芯片产品出口的重要市场、美国芯片行业利益巨大、高通 2018 年在华收入占比高达 67%、美国贸易摩擦的意图并非全方面无差别的断供芯片等因素综合判断:美国对中国实行芯片全面禁运,导致高通芯片对公司断供的可能性极低。

但公司仍无法排除在异常极端情况下,美国对中国实行芯片全面禁运,公司无法获得高通等关键芯片,将会造成公司在替代产品开发、认证周期内,存在无法继续为现有主要客户尤其是北美市场客户提供产品的情况,将会对公司生产经营造成重大不利影响。

(五)产品应用领域和客户集中度较高的风险

报告期内,公司产品主要应用于智慧能源及车联网领域,其中对电网行业客户和车联网客户 Harman 销售收入合计占当期营业收入之比分别为 39.84%、71.53%、68.18%和 68.04%,存在应用领域和客户集中度较高的风险。虽然公司与上述客户已形成稳定的合作关系,但若宏观经济变化、未来因产业政策调整、行业景气度下滑导致市场增速放缓,或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求,造成订单减少,且公司未能成功拓展新的应用领域和客户资源,将对公司的经营业绩带来不利影响。

(六)最近一年一期无线通信终端业务主要通过 Harman 开展的风险

公司无线通信终端产品主要是 4G 智能 OBD,面向海外车联网市场。公司自主研发搭载安卓智能操作系统的 4G 智能 OBD 终端,实现一款智能硬件适用 UBI、车队管理、汽车租赁等多种车联网场景,形成了差异化的产品优势。公司于 2016 年开始布局车联网业务,2017 年陆续实现 4G 智能 OBD 终端出货,并于 2018 年开始向海外市场大批量销售 4G 智能 OBD 终端,使得公司无线通信终端的收入大幅上升,带动公司经营业绩的提高。其中,最近一年一期公司 4G 智能 OBD 终端主要通过 Harman 向美国市场销售,公司对其销售 4G 智能 OBD 终端的收入占整体无线通信终端收入之比分别为 68.40%和 69.51%,占整体收入之比分别为 11.96%和 27.53%,占比较大。

(七)应收账款发生坏账的风险

随着公司销售规模的持续增长,公司应收账款持续增加,报告期各期末应收账款价值分别为 10,397.34 万元、18,109.77 万元、30,555.20 万元和 24,486.05 万元,占流动资产比重分别为 38.80%、48.42%、50.01%和 38.71%。公司智能电网领域主要直接客户为威胜控股、科陆电子和科大智能等大型企业或上市公司,最终客户主要为国家电网和南方电网等国有电力企业,由于行业惯例和终端客户特殊性使得应收账款坏账损失风险较低但回款周期普遍较长。应收账款是公司资产的重要组成部分,金额较大的应收账款影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量,对公司运营效率带来不利影响。若出现应收账款回款周期过长、不能按期收回或主要客户财务状况出现恶化,公司将可能面临一定的坏账损失风险,对公司的经营业绩产生不利影响。

由于产品应用领域和客户类型的差异,同行业可比公司之间的应收账款坏账准备政策存在差异。若公司对 1-3 个月的应收账款参照广和通及移远通信计提坏账准备,对公司经营业绩影响的模拟测算如下:

单位:万元

项目	2019年1-6 月	2018年	2017年	2016年
1-3个月应收账款余额	15,075.79	22,055.37	13,822.99	7,071.22
拟对 1-3 个月应收账款计提坏账所影响资产减值损失金额	-348.98	411.62	337.59	94.32
影响净利润金额	296.63	-349.88	-286.95	-80.18
模拟前净利润	1,987.52	4,349.52	5,157.78	2,094.79
模拟后净利润	2,284.15	3,999.64	4,870.83	2,014.61

(八)应收账款在信用期内未回款比例大幅上升的风险

报告期各期末,公司客户逾期的应收账款金额分别为 3,556.68 万元、2,919.33 万元、8,728.03 万元、10,419.55 万元,占同期末应收账款余额的比例分别为 33.50%、15.90%、28.01%、41.60%。报告期各期末公司逾期的应收账款金额较大,且 2018 年末、2019 年 6 月末较 2017 年末大幅上升,2018 年末和 2019 年 6 月末逾期的应收账款截至 2019 年 10 月 25 日回款金额分别为 7,307.48 万元、6,402.00 万元,回款比例分别为 83.72%、61.22%,期后回款总体情况良好。该等逾期主要来源于境内客户,尤其是智能电网领域客户。虽然智能电网领域的直接客户多为上市公司或上市公司成员企业,终端客户主要为国家电网和南方电网等国有电力企业,其信用和回款有保障,公司历史款项回收情况较好,实际发生的坏账损失较低,但大量的逾期应收账款增加了公司的应收账款管理难度、资金成本,以及在经济极端下行情况下直接客户因自身经营情况和资金状况恶化而产生的潜在坏账损失风险。

(九)经营性现金流量净额为负的风险

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -3,771.43 万元、-6,167.39 万元、-8,743.65 万元和 7,593.07 万元。报告期内,公司的主要客户包括国家电网、中国铁塔等大型国企的上游供应商,上述企业在采购定价、付款时间等方面占有主动地位,平均付款周期较长,从而使得公司应收账款回款时间偏长;同时,公司的主要原材料芯片生产厂商给予下游客户的账期较短。因此公司上下游的付款及收款结算存在一定的时间差,在公司营业收入增长的情况下经营活动产生的现金流量净额为负数。未来随着业务规模的进一步扩大,若公司不能有效控制应收账款回款速度及存货周转速度,持续强化现金流管理或银行借款等融资渠道筹集资金不及时,则公司的资金周转将面临一定的压力,从而对公司经营和业务扩张造成较大不利影响。

(十)公司产品毛利率下降的风险

报告期内,公司收入占比较高的产品为物联网无线通信模块和无线通信终端。公司无线通信模块产品按照返利业务匹配性原则测算的报告期各期毛利率分别为 27.19%、20.12%、19.15%和 16.68%,主要系随着通信制式的不断迭代,公司同一制式下的模块产品毛利率会随着技术不断成熟而有所下降;当 4G 技术在物联网行业大规模商用初期,公司率先推出 4G 全网通物联网无线通信模块,因此在 2016 年度获得较高的产品毛利率,但随着 4G 技术在物联网行业的应用日渐成熟,公司无线通信模块毛利率在 2017 年至 2019 年 1-6 月趋于稳定并有所下降。未来随着现有市场竞争的进一步加剧,在不考虑新的下游应用领域或新技术对无线通信模块产生新需求的前提下,公司现有无线通信模块产品的毛利率存在进一步持续下降的风险。

公司自 2017 年开始生产和销售无线通信终端,2017 年无线通信终端收入占比较低,2018 年开始大批量出货。2017 年至 2019 年 1-6 月公司无线通信终端产品毛利率分别为 35.07%、32.69%、29.89%%,毛利率水平整体略有下降,主要系 2017 年至 2019 年 1-6 月公司无线通信终端产品中毛利率相对较低的车联网终端产品的收入占比持续提升;车联网终端产品同期毛利率分别为 31.46%、31.49%、29.46%,占同期终端产品项下的销售金额之比分别为 44.29%、78.88%、98.19%,2019 年上半年,公司陆续拓展了 Harman 以外的海外车联网客户,对应的智能 OBD 型号产品毛利率稍低,使得车联网终端产品的毛利率有所下降。无线通信终端较无线通信模块毛利率更高且短期内相对稳定,主要系无线通信终端包括了无线通信模块到终端产品的研发、生产过程,具有更高的附加值,且具备完整功能、可供客户直接使用。公司目前无线通信终端产品中销售占比较高的车联网 4G 智能 OBD 主要面向欧美高端市场,报告期内国内能向欧美高端市场提供 4G 智能 OBD 产品的企业仅有公司和高新兴物联,竞争相对缓和。未来随着市场竞争的加剧,新竞争对手的进入,公司无线通信终端相对较高的毛利率存在下降的风险。

(十一)如高通返利政策变化可能对公司经营业绩产生的影响

报告期内,公司确认的高通返利金额较大,分别为 282.80 万元、7,715.69 万元、9,033.75 万元和 3,670.54 万元。返利政策系高通等芯片厂商长期以来的市场开拓策略之一,公司与其他物联网模块厂家一样,根据芯片厂商的采购价格、返利情况、及客户和应用领域等因素综合制定相关产品的价格策略。如因贸易摩擦加剧或其他因素,使得高通针对公司大幅调整或取消返利政策,将可能在短期内对公司经营业绩和生产经营造成重大影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容

本公司首次公开发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2971 号”文同意注册,具体内容如下:

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

(二)上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所《关于深圳市有方科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》(〔2020〕31 号)批准,公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市,公司 A 股股本为 9,167.9495 万股(每股面值 1.00 元)。其中 1,866.0655 万股股票将于 2020 年 1 月 23 日起上市交易。证券简称为“有方科技”,证券代码为“688159”。

二、股票上市相关信息

(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板

(二)上市时间:2020 年 1 月 23 日

(三)股票简称:有方科技;扩位简称:有方科技

(四)股票代码:688159

(五)本次公开发行后总股本:9,167.9495 万股

(六)本次公开发行股票数量:2,292 万股,全部为公开发行新股

(七)本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量:1,866.0655 万股

(八)本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量:7,301.8840 万股

(九)战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量:

保荐机构另类投资子公司兴贵投资有限公司获配数量为 114.60 万股,公司高级管理人员与核心员工专项资产管理计划华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“钱景 1 号”)获配数量为 229.20 万股。

(十)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

(十一)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”。

(十二)本次上市股份的其他限售安排

兴贵投资有限公司本次获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

华创证券钱景 1 号科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股票的限售期为 12 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

本次发行中网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10% 的最终获配账户(向上取整计算),将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果,10% 的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为 252 个,这部分账户对应的股份数量为 82.1345 万股,占网下发行总量的 7.03%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.22%,占本次发行总量的 3.58%。

(十三)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十四)上市保荐机构:华创证券有限责任公司

三、本次发行选择的具体上市标准

发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第(一)项“预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”中规定的市值及财务指标。

本次发行价格为 20.35 元/股,发行后公司总股本为 9,167.9495 万股,上市时公司市值约为 18.66 亿元,不低于人民币 10 亿元。2017 年度和 2018 年度,发行人归属于母公司股东的净利润分别为 5,157.78 万元和 4,349.52 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 4,776.28 万元和 3,783.19 万元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元;2018 年发行人营业收入为 55,713.56 万元,不低于人民币 1 亿元。因此,发行人本次公开发行后达到了相应的上市标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人基本情况

中文名称	深圳市有方科技股份有限公司
英文名称	Shenzhen Neoway Technology Co., Ltd.
注册资本	6,875.9495 万元(本次发行前)
法定代表人	王慷
有限公司成立日期	2006年 10 月 18 日
整体变更日期	2015年 8 月 19 日
住所	深圳市龙华区大浪街道同胜社区华荣路联建工业园厂房 2 号 4 层
邮政编码	518109
电话号码	0755-33692165
传真号码	0755-29672566
互联网网址	www.neoway.com
电子信箱	nw@neoway.com
负责信息披露和投资者关系的部门、负责人、联系电话	部门:董事会办公室 负责人:姚凤娟(董事会秘书) 联系电话:0755-33692165
经营范围	电子产品的技术开发、销售;电子通讯产品、通讯模块的技术开发及销售;通讯模块软件的技术开发、销售及相关技术咨询;车联网终端、车载智能终端、物联网通信终端的技术开发及销售;其它国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。电子通讯产品、通讯模块、车联网终端、车载智能终端、物联网通信终端的生产加工
主营业务	物联网无线通信模块、物联网无线通信终端和物联网无线通信解决方案的研发、生产(外协加工方式实现)及销售
所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)

二、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东基本情况

公司控股股东为深圳市基思瑞投资发展有限公司。本次发行前,深圳市基思瑞投资发展有限公司直接持有本公司 31.47% 的股份。

深圳市基思瑞投资发展有限公司基本情况如下:

公司名称	深圳市基思瑞投资发展有限公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	1,000 万元(实收资本:1,000 万元)
法定代表人	王慷
成立日期	2011年 5 月 18 日
经营期限	自 2011 年 5 月 18 日起至 2021 年 5 月 18 日止
注册地址及主要生产经营地	深圳市龙华区大浪街道华荣路联建科技工业园 3 栋 2 楼 A 区
经营范围	投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含期货、证券、保险及其他金融业务);企业管理咨询。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)
统一社会信用代码	914403005747545 9XK
主营业务及其与公司主营业务的关系	除进行股权投资外,未经营其他业务
主要财务数据(万元)(经立信审计)	项目 / 2019年 6 月 30 日 /2019 年 1-6 月 / 2018年 12 月 31 日 /2018 年度 总资产 / 6,702.79 / 6,467.02 净资产 / 1,388.66 / 1,582.06 营业收入 / - / - 净利润 / -193.39 / -3,583.61

(二)实际控制人基本情况

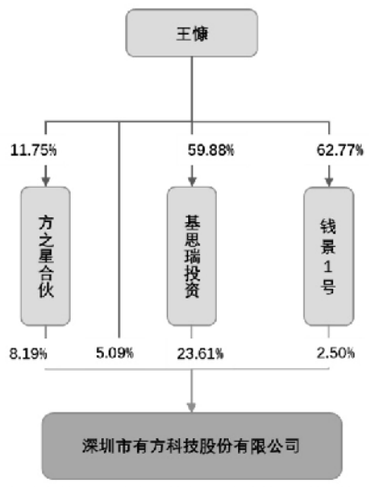
王慷为公司实际控制人,公司实际控制人最近两年没有发生变更。本次发行前,王慷直接持有公司 6.79% 的股权,同时因王慷持有公司股东深圳市基思瑞投资发展有限公司 59.88% 的股权、深圳市方之星投资合伙企业(有限合伙)11.75% 的出资份额,且深圳市基思瑞投资发展有限公司、深圳市方之星投资合伙企业(有限合伙)分别持有公司 31.47%、10.92% 的股权,王慷间接持有公司 20.13% 的股权,因此,王慷直接和间接合计持有公司 26.92% 的股权,合计控制公司 38.26% 的股权。王慷对公司具有控股权,系公司的实际控制人。

王慷基本情况如下:

王慷,男,中国国籍,无境外永久居留权,生于 1970 年 9 月,北京大学 MBA。1991 年 9 月至 1998 年 2 月,任职于航空部陕西省千山电子仪器厂;1998 年 3 月至 2009 年 12 月,任职于中兴通讯股份有限公司,历任硬件工程师、传输硬件开发部部长、中兴移动副总经理等职务;2011 年 6 月至 2015 年 7 月,任有方有限执行董事兼总经理,2015 年 8 月至今,任公司董事长兼总经理。

(三)本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

本次发行后,发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下:



三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况及持股情况

(一)董事基本情况

截至本上市公告书签署日,公司董事会由 9 名董事组成,其中 3 名为独立董事,公司现任董事情况如下:

序号	姓名	职务	任职起止日期
1	王慷	董事长	2018年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 14 日
2	张增国	董事	
3	魏琼	董事	
4	杜广	董事	
5	喻斌	董事	
6	刘培龙	董事	
7	徐小伍	独立董事	
8	陈会军	独立董事	
9	曾明	独立董事	

(二)监事基本情况

截至本上市公告书签署日,公司监事会由 3 名监事组成,公司现任监事情况如下:

序号	姓名	职务	任职起止日期
1	熊杰	监事会主席	2018年 10 月 15 日至 2021 年 10 月 14 日
2	贺降强	监事	
3	黄丽敏	职工代表监事	

(三)高级管理人员基本情况

截至本上市公告书签署日,公司现任高级管理人员情况如下:

序号	姓名	职务	任职起止日期
1	王慷	总经理	2018年 10 月 25 日至 2021 年 10 月 14 日
2	张增国	副总经理	
3	魏琼	副总经理	
4	张楷文	副总经理	
5	杜广	副总经理	
6	姚凤娟	副总经理、董事会秘书	
7	李银耿	财务总监	

(四)核心技术人员基本情况

截至本上市公告书签署日,公司核心技术人员共 11 名,核心技术人员基本情况如下:

序号	姓名	职务
1	王慷	董事长、总经理
2	张增国	董事、副总经理
3	杜广	董事、副总经理
4	张楷文	副总经理
5	肖悦赏	首席技术官
6	林深	研发办公室软件总工程师
7	彭焰	系统部部长
8	汤柯夫	电器设备联网解决方案 BU 总经理
9	田同军	市场部系统工程师、产品部产品经理
10	郭建林	研发总经理
11	尚江峰	软件二部部长

(五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属在发行后直接和间接持有公司股份(不含公司高级管理人员及核心员工通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的股份)情况如下:

单位:万股

姓名	职务	直接持股情况		间接持股情况		合计持股情况	
		数量	比例	数量	比例	数量	比例